

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称	太平基金、九泰基金、长信基金、兴证全球基金、华夏基金、招商基金、鹏华基金、中航基金、英大基金、泓德基金、中信建投基金、交银施罗德基金、长安基金、富国基金、博时基金、中信证券、国海证券、山西证券、东海证券、中金公司、瑞银证券、华泰证券、华安证券、光大证券、华金证券、汇丰前海证券、摩根大通证券、东方财富证券、东吴证券、国信证券、国元证券、广发证券、华西证券、红塔证券、东方证券、国金证券、上海瞰道资管、循远资管、益和源资管、上海睿郡资管、北京枫泉资管、青岛鸿竹资管、上海禾升资管、上海云门资管、北京逸原达资管、深圳慧利资管、瀚亚投资（香港）、浩成资管、博裕资管、瑞银集团、高盛（亚洲）、鲁信国际金融、交银国际、美银证券、摩根士丹利银行、元昊资本等
时间	2025 年 10 月 30 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰 董事会秘书：刘丽琼
投资者关系活动主要内容介绍	一、简要介绍公司 2025 年前三季度整体情况概述 报告期内，公司着力布局两大体系的发展：在产品维度，着力构建高性能射频前端芯片及模组的产研能力和先进架构，以平台化资源赋能

	客户价值创造，为拓展复合产品应用、多元化产品类别和跨行业应用奠定基础；在技术维度，公司持续布局 6 英寸特种工艺、12 英寸异质硅基工艺平台及先进异构集成三大核心技术平台，通过延展“异质+异构”的技术路线，协同优化材料、工艺、器件与封装等环节，持续完善差异化、高端定制化、高度集成化等系列产品，着力强化“资源平台领先、产品领先、成本领先、质量领先”的综合优势。 二、在问答环节，主要回复如下： 1、请问公司关于三季度业绩表现及影响因素，以及对未来季度的预期情况？ A：尊敬的投资者，您好！2025 年前三季度，公司实现营业收入 27.69 亿元，同比下降 17.77%，归属于上市公司股东的净利润-1.71 亿元，同比下降 140.13%；整体毛利率 26.68%，同比下降 13.84%，主要系受到芯卓折旧、市场竞争及产品结构变化等因素影响。 随着行业淡旺季的转换，需求景气度有所提升，公司的经营情况逐渐向好。第三季度，公司实现营业收入 10.65 亿元，环比增长 12.36%，归属于上市公司股东的净利润-2,333.64 万元，净利润亏损环比大幅度收窄 76.84%。毛利方面，第三季度，芯卓自产品圆成本对毛利的影响环比第二季度有所改善，预计随着芯卓产能利用率的提升，自产品圆成本对整体毛利率的负面影响将逐步减弱。产品方面，预计公司多款重要模组产品会迎来快速增长。感谢您对公司的关注！ 2、请问公司预计明年的国内射频竞争格局？ A：尊敬的投资者，您好！在部分技术门槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。从技术发展来看，6G、卫星通讯等新型通讯需求的出现，一定程度上将驱使射频前端芯片能力的提升，对企业保持领先的技术储备、技术预研能力提出更为全面的要求；随着射频前端产品差异化、集成化、高端化需求愈发旺盛，规模更大、产品线更完善、具有更强供应链调节能力的企业将获得更高的市场认可度与青睐。感谢您对公司的关注！ 3、请问公司相关专利和诉讼的进展？ A：尊敬的投资者，您好！公司深耕射频前端行业多年，在资源投入、专利布局与生态协同方面进行了长期、正向的建设，积累并构建了较高的技术壁垒和分析能力。2025 年上半年，公司与株式会社村田制作所（以下简称“村田”）涉及共 7 项专利纠纷。公司认为，涉诉的 7 项专利申请前已存在多项现有技术。并且在 2025 年 1 月，上述 7 项专利所依托的基础专利已被国家知识产权局宣告无效，本次涉诉的韩国 3 项专利及中国 3
--	--

项专利均系在该无效专利基础上通过多个技术细节叠加形成，其余 1 项中国专利系在该无效专利的结构基础上分析了一系列数学表达式而成，因此，涉案专利缺乏本质创新性，专利的有效性和稳定性存疑。

公司对村田的主张不予认可，目前已就上述 7 项涉案专利提起了无效宣告程序，具体进展请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

4、请问公司目前 WiFi 7 等非射频模组的产品和份额情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，WiFi 7 模组、蓝牙前端模组及射频 MCU 类产品已实现稳定出货。目前，公司 WiFi 7 模组产品进展良好，出货量已多于 WiFi 6 产品，并且在智能手机、组网设备等领域均有业务拓展。随着这些产品的市场化推进加速及需求的持续提升，预计会在第四季度持续增长。感谢您对公司的关注！

5、请问公司目前两条产线的表现情况如何？

A：尊敬的投资者，您好！目前公司 6 英寸和 12 英寸两条产线均保持大规模交付的状态。相较于今年上半年，两条产线产能利用率均呈现出较为明显的提升。关键技术平台实现从产品验证完成到稳定产出的转化，产品良率和产线良率双双达到行业内较高水平。

6 英寸滤波器晶圆生产线针对特种材料工艺进行平台建设，集成自产滤波器的多个模组产品持续规模出货。截至报告期末，6 英寸产能利用率提升明显。

12 英寸以硅基技术平台生产线为基础，致力于异质材料及特种工艺的能力拓展。公司第一、二代技术平台已实现规模量产并持续推进第三代工艺的研发工作。截至报告期末，公司 12 英寸射频芯片生产线整体产能利用率情况较好。感谢您对公司的关注！

6、请问目前 L-PAMiD 模组的产品进展和出货情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，L-PAMiD 模组产品已在多家品牌客户导入并交付，同时可支持不同射频解决方案的不同频段产品，L-PAMiD 产品的性能及表现与滤波器工艺密切相关，随着公司滤波器工艺能力持续提升以及多类高质量产品的交付，未来也将力争把握更多的市场机遇。感谢您对公司的关注！

7、请问公司目前存货的构成情况？

A：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，公司存货约 30.16 亿元，较去年同比增长 19.64%。为保障两条产线产出快速爬坡、支撑重要模组产品的交付放量，公司适当地增加了原材料储备。目前，存货仍以基础材料备货为主。感谢您对公司的关注！

	8、请问公司射频模组产品的技术储备和市场进展如何？与海外厂商（如村田）相比，国内品牌客户对定制化射频方案的需求是新增的吗？A： 尊敬的投资者，您好！公司基于资源平台所带来的全品类产品能力，在射频模组方向有诸多技术储备和产品创新，例如对多频段进行定制化、参与 phase X 方案定义等。 过去几年，国内品牌客户对定制化射频方案的需求相对较弱，更关注摄影摄像、屏幕等易被消费者感知的功能。近两年，智能手机端竞争进入新阶段，品牌客户开始逐步细化关注射频性能，因此对定制化射频方案产生新增需求。公司是国内较早布局自主射频前端全品类产品能力的厂商，在高端高性能射频前端芯片及模组等更需要工艺与设计深度协同的领域，充分地发挥 Fab-Lite 经营模式的优势，保持着国内射频前端市场的领先地位。基于芯卓的资源及能力建设，公司可以针对客户特殊需求精准定位客户所需要的产品。感谢您对公司的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 10 月 30 日